

機械器具(58) 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具（JMDN コード：70965001）
TMサイナスリフトキット MK-II

***【禁忌・禁止】**

適応対象（患者）

以下の患者には使用しない。[骨癒合の不足やインプラントの失敗が起こる可能性があるため。]

1. 骨の質量が低下している患者。
2. 感染症を発症している患者。
3. 以下の状態の患者：
血液供給の制限、潜在的な感染症免疫不全、放射線照射を受けた患者、重度の糖尿病、重度の骨粗鬆症。

【形状・構造及び原理等】

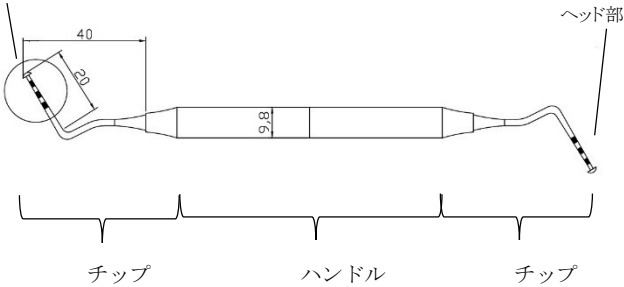
1. 形状・構造

本品はハンドルの両側にデプスゲージ、上顎洞底粘膜の剥離、骨補填材の充填、凝縮の機能を持つ #1、#2、#3 がある。#2、#3 の作業部はシャンクに対して 45°、90° の角度を呈している。

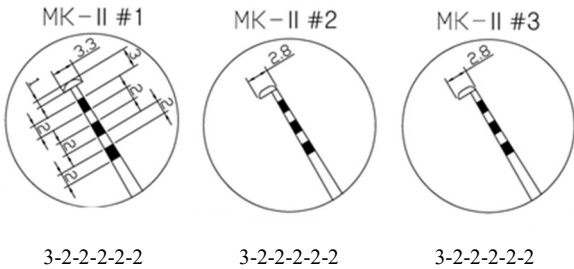
全長：約 184 mm、ハンドル部直径：9.8 mm、

ヘッド部直径：下表参照

ヘッド部



デプスゲージの目盛は下図のとおりである。



種類名	作業部角度 (シャンクに対して)	ヘッド部直径/厚さ (mm)	ハンドル
#1	—	3.3 と 2.8/1.0	ブラック
#2	45°	どちらも 2.8/1.0	ブルー
#3	90°	どちらも 2.8/1.0	レッド

2. 体に接触する部分の主な組成

チップ：ステンレス鋼

3. 原理

本品のハンドルを保持し、作業部（チップ）で穿孔底の探査や上顎洞底粘膜の剥離、骨補填材等の充填、凝縮を行う。

【使用目的又は効果】

本品はインプラント手術に用いる。本品は上顎洞の深さの測定、穿孔底の探査や上顎洞粘膜の剥離、骨補填材等の充填、凝縮に使用する。

【使用方法等】

[使用方法]

1. インプラントの埋入窩に応じて #1 の作業部を選択する。
2. デプスゲージを使用して、歯槽頂からの開洞後にヘッド部を洞底部骨に掛けるように上顎洞粘膜を剥離する。（必要に応じて挙上距離を計測する。）
3. 追加で剥離を行う場合は、#2 ないし #3 を使用し剥離を広げる。
4. 部位に応じて #1、#2、#3 の作業部を使用し、洞底部と上顎洞粘膜の隙間に骨補填材等の充填、凝縮を行う。

***【使用上の注意】**

<重要な基本的注意>

1. 手術による不必要な損傷を最小限に抑えるため、解剖学的構造およびインプラント部位に十分注意してください。

【保守・点検に係る事項】

<滅菌>

初回使用前と毎診療後に、必ず高压蒸気滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件：121℃ 30 分間
134℃ 15 分間
135℃以上に加熱しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社アルファメッド
東京都港区西麻布 3-6-4

販売元：株式会社モリタ

[お問い合わせ先]

問合せ窓口：株式会社モリタ お客様相談センター
電話番号：0800-222-8020（無料）
Fax 番号：0800-222-6480（無料）
E-mail：e-customer@morita.com

製造業者：MCTBIO

国名：大韓民国